

杭州士兰微电子股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本公司及相关控股子公司（以下合称“公司”）与关联方厦门士兰集科微电子有限公司（以下简称“士兰集科”）的日常关联交易尚须获得股东大会的批准。

公司与关联方杭州友旺电子有限公司（以下简称“友旺电子”）、杭州士腾科技有限公司（以下简称“士腾科技”）的日常关联交易无须提交股东大会审议。

● 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 7 日召开，会议审议通过了《关于与友旺电子日常关联交易的议案》《关于与士腾科技日常关联交易的议案》和《关于与士兰集科日常关联交易的议案》。

在审议与友旺电子的日常关联交易议案中，关联董事陈向东、罗华兵回避表决；在审议与士腾科技的日常关联交易议案中，关联董事陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵回避表决；在审议与士兰集科的日常关联交易议案中，关联董事陈向东、范伟宏、穆远回避表决；其余非关联董事、独立董事一致表决通过了上述议案。

公司与关联方士兰集科的日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司与关联方友旺电子和士腾科技的日常关联交易所涉金额在董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

上述关联交易议案已经 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体独立董事认为：公司与关联方友旺电子、士腾科技和士兰集科的日常关联交易符合公平、公正原则，对公司完成 2024 年生产销售计划有积极影响，对公司的经营发展具有良好的促进作用，对公司的独立性没有影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于与友旺电子日常关联交易的议案》《关于与士腾科技日常关联交易的议案》《关于与士兰集科日常关联交易的议案》提交董事会审议。

（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

（币种：人民币）

关联方	关联交易类别	关联交易内容	交易金额		预计金额与实际发生金额差异较大的原因
			2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	
友旺电子	向关联人销售货物	出售芯片产成品	不超过 2 亿元	1.25 亿元	受市场影响，业务量未达预期
	向关联人提供劳务	提供技术服务	0	9.22 万元	不适用
士腾科技	向关联人销售货物	销售芯片	不超过 7,000 万元	3,527 万元	不适用
士兰集科	向关联人采购商品	采购芯片、原材料、设备、备品备件等	不超过 30 亿元	21.38 亿元	受市场影响，业务量未达预期
	向关联人提供劳务	提供加工服务	不超过 2 亿元	0.87 亿元	
	向关联人销售商品	销售产品、设备、备品备件等	不超过 3 亿元	1.29 亿元	
	接受关联人提供的劳务	接受加工服务	0	0.04 亿元	不适用
士兰明镓 (注)	向关联人销售商品	销售原材料、设备、备品备件等	不超过 2.5 亿元	2.27 亿元	不适用
	向关联人提供劳务	提供加工服务	不超过 1,000 万元	129.42 万元	不适用
	向关联人采购商品	采购芯片、原材料、设备、备品备件等	不超过 6 亿元	2.63 亿元	受市场影响，业务量未达预期
	接受关联人提供的劳务	接受加工服务	不超过 4,000 万元	1,479.50 万元	不适用

注：士兰明镓已于 2023 年 11 月纳入本公司合并报表范围，不再属于关联方，其关联交易实际发生金额统计时段为 2023 年 1-10 月。

(三) 2024 年日常关联交易预计的金额和类别

(币种: 人民币)

关联方	关联交易类别	关联交易内容	2024 年预计金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
友旺电子	向关联人销售货物、提供劳务	出售芯片产成品、提供技术开发服务	不超过 2 亿元	预计业务量增加
士腾科技	向关联人销售货物等	销售芯片	不超过 7,000 万元	不适用
士兰集科	向关联人采购商品	采购芯片、原材料、备品备件等	不超过 30 亿元	预计业务量增加
	接受关联人提供的劳务	接受加工服务、食堂、宿舍、电站运维等	不超过 0.2 亿元	不适用
	向关联人提供劳务	提供加工服务	不超过 1.5 亿元	预计业务量增加
	向关联人销售商品	销售产品、设备、备品备件等	不超过 5 亿元	预计业务量增加

自 2024 年 1 月 1 日起至公司 2024 年年度股东大会召开日前,公司与士兰集科在本预计范围内的日常关联交易,公司均认为有效。

自 2024 年 1 月 1 日起至第八届董事会第二十次会议审议通过前,公司与友旺电子和士腾科技在本预计范围内的日常关联交易,公司均认为有效。

公司 2024 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司可根据实际交易情况,在同一关联方的不同关联交易类型间进行额度调剂,总额不超过预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 杭州友旺电子有限公司

- 1、统一社会信用代码: 9133010060916630XC
- 2、企业类型: 有限责任公司(台港澳与境内合资)
- 3、公司地址: 浙江省杭州市滨江区环兴路 1 号
- 4、注册资本: 300 万美元
- 5、法定代表人: 高耿辉
- 6、成立日期: 1994 年 4 月 27 日
- 7、营业期限: 1994 年 4 月 27 日至 2034 年 4 月 26 日
- 8、经营范围: 半导体集成电路和分立器件的设计、生产和应用服务。
- 9、股东情况: 友顺科技股份有限公司持有其 60% 股权, 本公司持有其 40% 股权。

10、主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，友旺电子经审计的合并报表总资产为 35,049 万元，负债 13,107 万元，净资产 21,942 万元。2023 年营业收入为 32,803 万元，净利润为 794 万元。友旺电子资产负债率为 37.40%。

11、关联关系：本公司董事长陈向东先生在友旺电子担任副董事长，董事罗华兵先生在友旺电子担任董事兼总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，友旺电子为公司关联法人。

12、关联方履约能力分析：友旺电子目前依法存续且生产经营正常，具备良好的履约能力。友旺电子未被列为失信被执行人。

（二）杭州士腾科技有限公司

1、统一社会信用代码：91330108749451700C

2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、公司地址：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号 14 号楼 2 楼

4、注册资本：2,046 万元

5、法定代表人：陈向东

6、成立日期：2003 年 4 月 16 日

7、营业期限：2003 年 4 月 16 日至长期

8、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；电机及其控制系统研发；物联网技术研发；物联网技术服务；智能机器人的研发；汽车零部件研发；工业自动控制系统装置制造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

9、股东情况：杭州士兰控股有限公司持有其 57.36% 的股权，本公司持有其 4.89% 的股权，其他股东合计持有其 37.75% 的股权。

10、主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，士腾科技经审计的总资产为 20,267 万元，负债为 12,346 万元，净资产为 7,922 万元。2023 年营业收入为 23,915

万元，净利润为 1,990 万元。士腾科技资产负债率为 60.91%。

11、关联关系：本公司控股股东杭州士兰控股有限公司系士腾科技的控股股东。本公司董事长陈向东先生在士腾科技任董事长，董事郑少波先生在士腾科技任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，士腾科技为公司关联法人。

12、关联方履约能力分析：士腾科技目前依法存续且生产经营正常，具备良好的履约能力。士腾科技未被列为失信被执行人。

（三）厦门士兰集科微电子有限公司

1、统一社会信用代码：91350200MA31GA8Q1C

2、企业类型：其他有限责任公司

3、住所：厦门市海沧区兰英路 89 号

4、法定代表人：裴华

5、注册资本：3,827,953,681 元

6、成立日期：2018 年 2 月 1 日

7、营业期限：2018 年 2 月 1 日至 2068 年 1 月 31 日

8、经营范围：集成电路制造；半导体分立器件制造；电子元件及组件制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）。

9、股东情况：厦门半导体投资集团有限公司持有 66.626%，本公司持有 18.719%，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持有 14.655%。

10、主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，士兰集科未经审计的总资产为 881,068 万元，负债为 572,528 万元，净资产为 308,540 万元。2023 年度营业收入为 215,052 万元，净利润为-41,973 万元。士兰集科资产负债率为 64.98%。

11、关联关系：本公司董事陈向东先生、范伟宏先生和穆远先生在士兰集科担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，士兰集科为本公司关联法人。

12、关联方履约能力分析：士兰集科目前依法存续且生产经营正常，具备良好的履约能力。士兰集科未被列为失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易本着自愿、平等、互利的原则进行，交易的定价均以市场价格为基础协商确定，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

本公司及相关控股子公司与上述关联方将在董事会/股东大会审议通过后在上述额度范围内签订相关交易合同。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易均是为了满足日常生产经营的需要，均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，交易定价公允合理，对公司完成 2024 年生产销售计划有积极影响，对公司的经营发展具有良好的促进作用。该交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司的独立性没有影响，不会对关联方形成依赖。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日